日本電子機械工業会規格
Standard of Electronic Industries Association of Japan

EIAJ ED-7311-5A

集積回路パッケージ個別規格
(SRAM／Flash用FBGA)
Standard of integrated circuits package
[SRAM／Flash Fine-pitch Ball Grid Array(FBGA)]

１９９８年４月制定
２０００年２月改正

作成
半導体パッケージ標準化委員会
Technical Standardization Committee on Semiconductor Device Package

発行
社団法人 日本電子機械工業会
Electronic Industries Association of Japan

登録一覧表

Registration Table

パッケージ名称：FBGA(0.80/0.75/0.65mm pitch)
Package Name

登録番号：IC-0000-001
Registration No.

呼び寸法 E×D Nominal dimensions	端子直線間隔 e Terminal pitch		
	0.65	0.75	0.80
E=4.10～12.00 D=5.40～15.00	48-001-AA		
E=4.60～12.00 D=6.10～15.00		48-001-AB	
6.00× 8.00			48-001-AC 48-001-AD 48-001-AE
6.00×10.00			32-001-BA
10.00× 8.00			56-001-CA
8.00× 8.00			64-001-DA
9.00× 9.00			65001-EA
8.00×10.00			68-001-FA
11.00× 8.00			72-001-GA
8.00×11.00			73-001-HA
9.00×11.00			73-001-HB
9.00×12.00			73-001-HC
9.00×14.00			77-001-IA

注　表中の数値は、「(端子数ｎ) -(連番)-(整理番号)」を示す。
Note: Numerals in the Table indicate "(Terminal number n)-(Consecutive number)-(Serial number)"

	EIAJ STANDARD PACKAGE OUTLINE DRAWINGS	DATE 99-07-21	SHEET 1/11
PACKAGE NAME FBGA		EIAJ REGISTRATION NO. IC-0000-001	